

TIA®800AL 可大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有优秀的粘合强度和良好的导热率，旨在替代传统的机械固定和导热硅脂，简化组装工艺，提升产品可靠性，是解决现代紧凑型电子设备散热挑战的理想选择。



特性

- 》高粘结强度
- 》良好的导热效率
- 》施工便捷，可模切定制尺寸
- 》可在较宽工作温度范围内保持性能稳定

应用

- 》LED 模组
- 》功率器件
- 》消费电子
- 》通讯设备

TIA® 800AL 系列特性表

产品名称	TIA® 806AL	TIA® 808AL	TIA® 810AL	测试方法
颜色	白色			目测
胶粘剂类型	亚克力胶粘剂			-
基材类型	铝箔			-
建议使用温度范围 (°C)	-40~125			-
厚度 (inch/mm)	0.006 0.15	0.008 0.20	0.010 0.25	ASTM D374
击穿电压 (V)	≥1000	≥1200	≥1500	ASTM D149
热传导率 (W/m·K)	1.6			ASTM D5470
180°剥离强度 (gf/inch) 不锈钢, 即时	≥1200			ASTM D3330
180°剥离强度 (gf/inch) 不锈钢, 24小时	≥1400			ASTM D3330
保持力 (H/inch) @25°C	≥48			ASTM D3654
保持力 (H/inch) @80°C	≥48			ASTM D3654

产品规格

标准厚度: 0.006"(0.15 mm) , 0.008"(0.20 mm), 0.010" (0.25 mm)
标准尺寸: 16"×100" (406 mm× 30.48 m)
补强载体: TIA®800AL系列卷材可带铝箔为补强

TIA®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2988559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIA800AL-0226